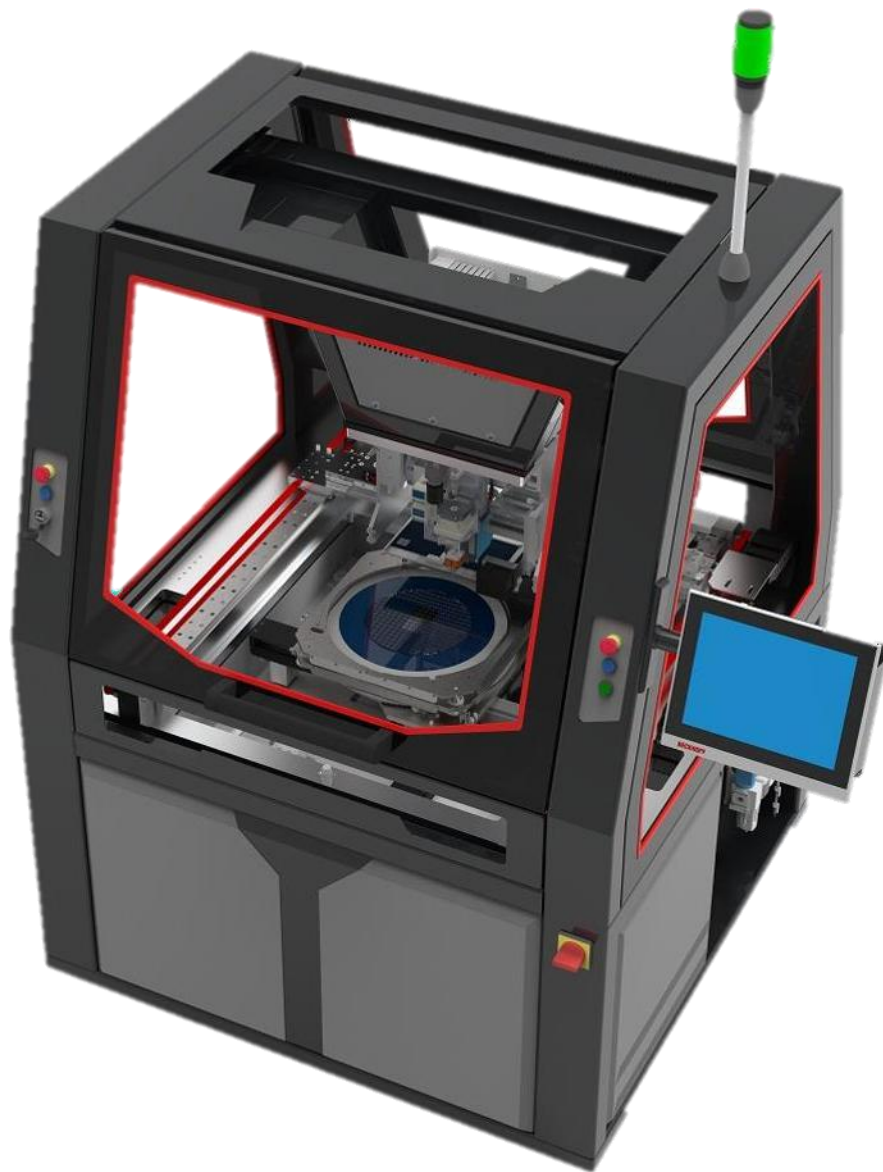


Levio

零接触式取 & 放机器



靖江市森博机电科技有限公司

186 4618 6345

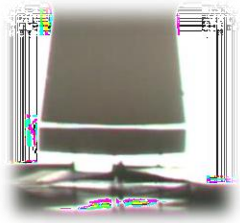


Die ejection module

Levio中配置的工件取出模块允许从载体上完全无接触的取放工件

工件取放是最容易产生缺陷的工艺步骤之一。使用非接触技术，您可以完全避免接触导致的缺陷。

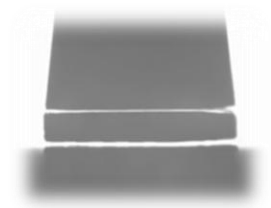
可用于尺寸从4英寸到12英寸的晶片，具有多种基板材料和厚度。



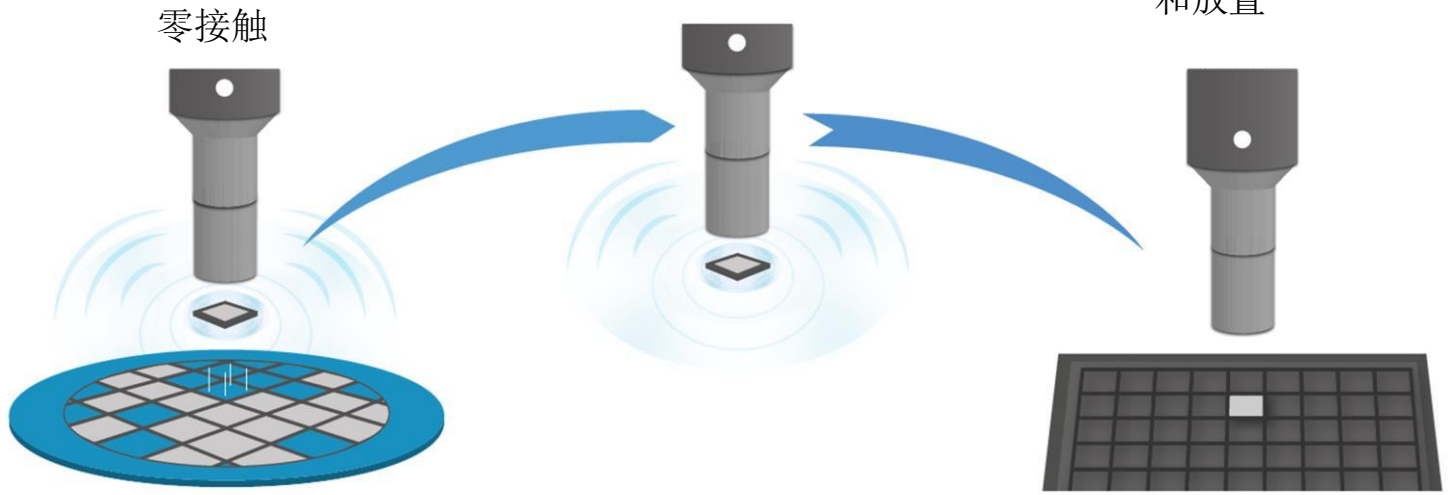
捡取



零接触
运输



自动中心定位
和放置

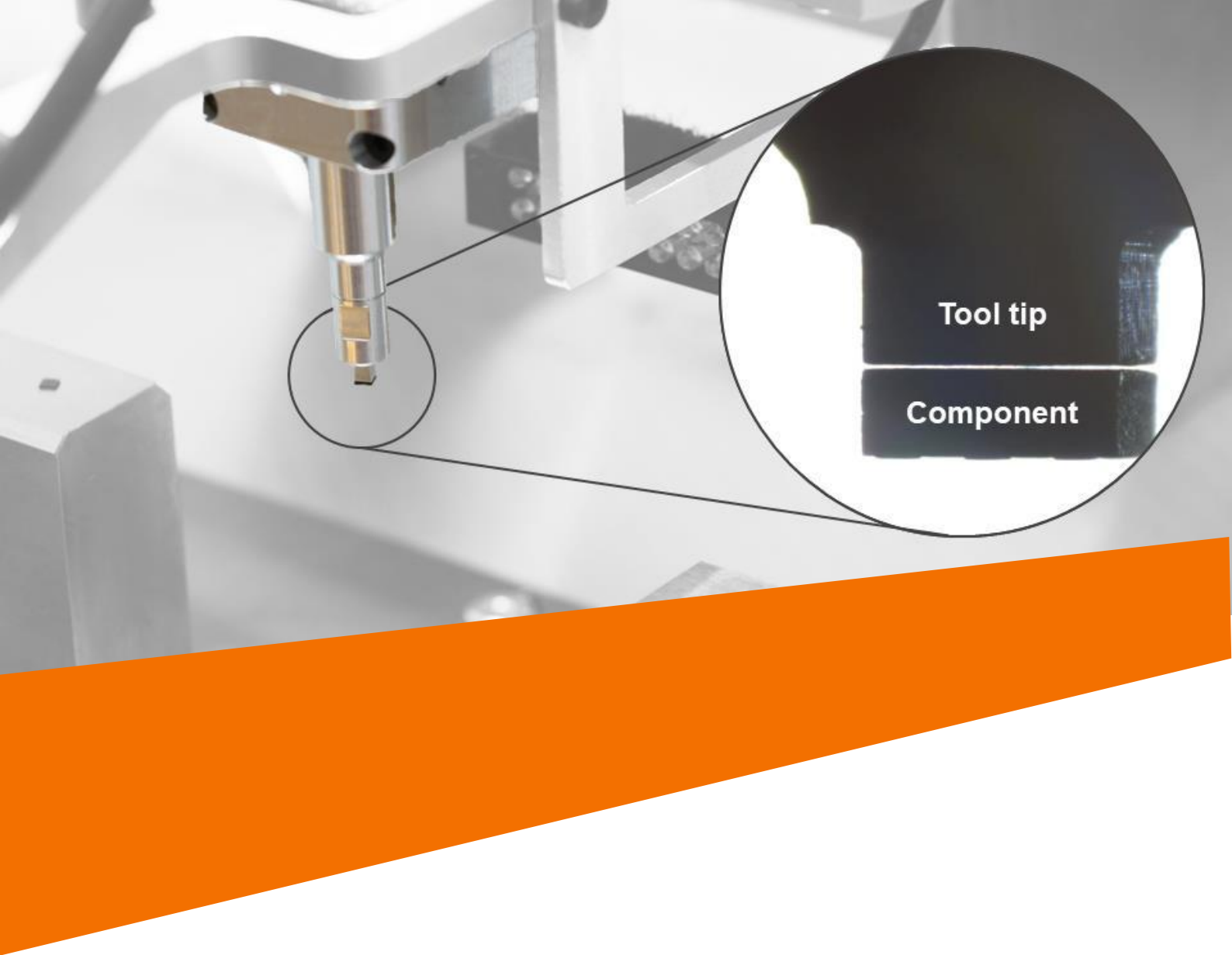


零接触过程

Levio允许执行一个完整的过程，
从晶圆到载体或从载体到载体，完全不接触。

该元件可以从晶圆或输入载体上取下，
进行检查并放置在广泛的输出载体中。
所有这些都是在不接触上表面的情况下进行的。

这使得生产过程更清洁，产量和质量更高

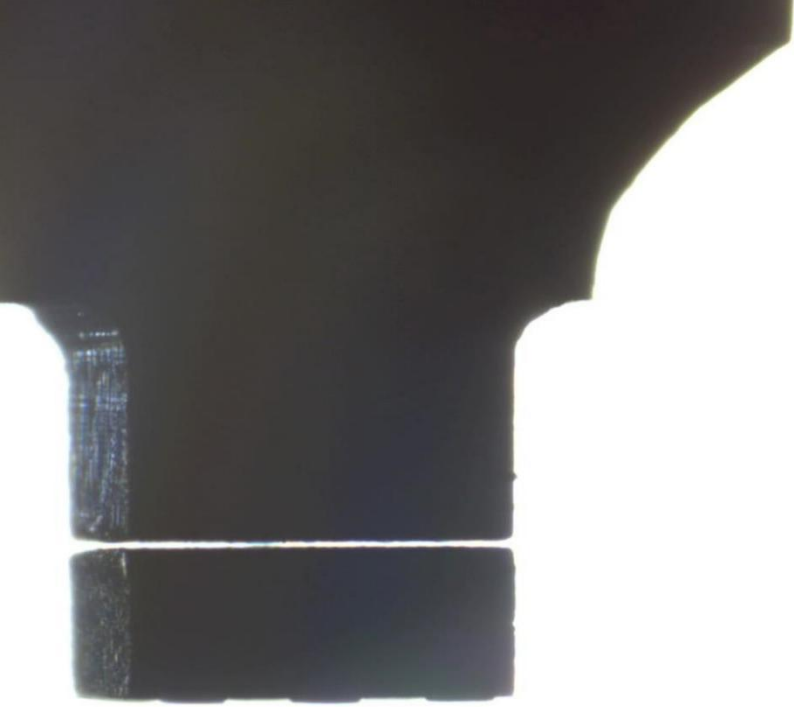


完全零接触式操作

零接触自动化新技术允许对任何材料的组件进行零接触操作。

由于其气流和压力的组合，它可以悬浮组件并极其小心地操纵它们。

了解更多有关技术的信息在
touchless-automation.ch

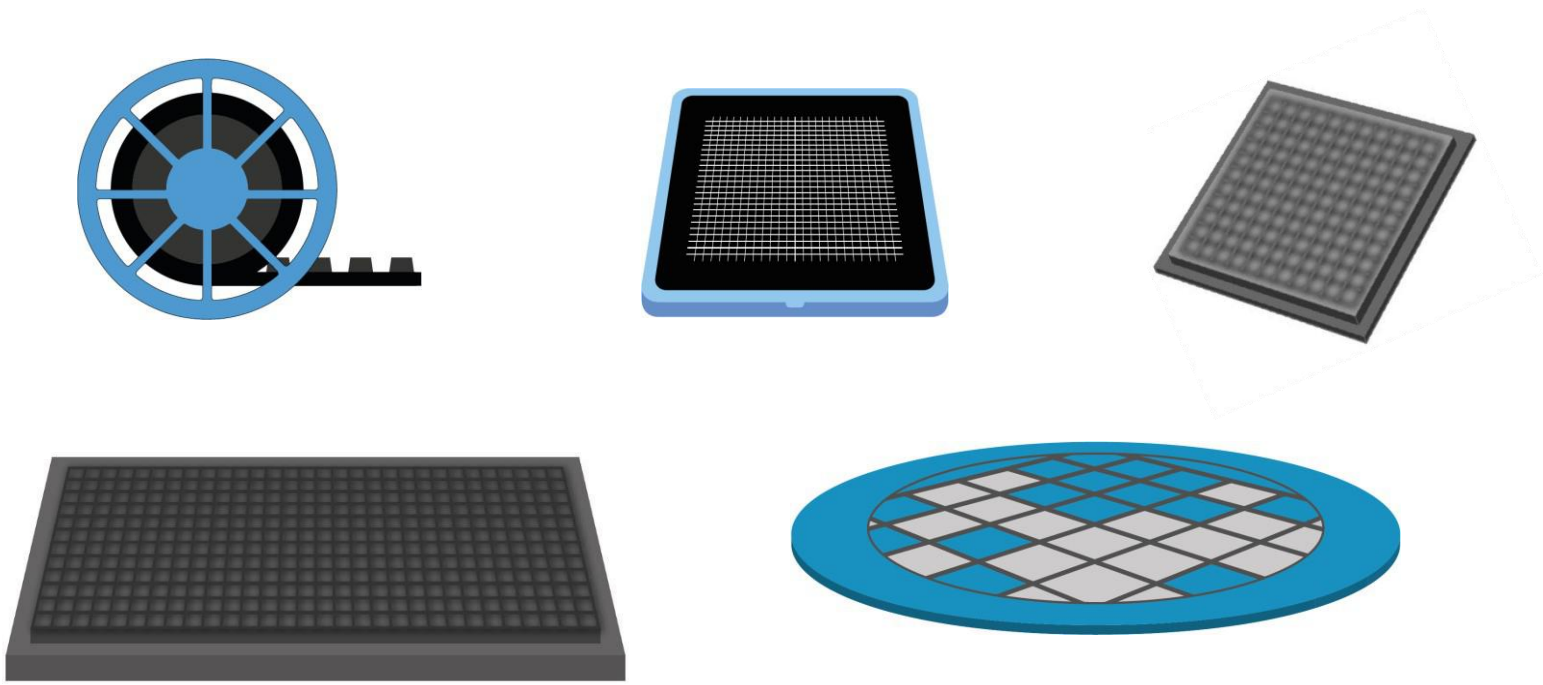


自动定位

零接触式技术可以自动将部件集中在抓取工具的顶端

而无需机械工具或昂贵的视觉模块。背后的原因在于正在开发的物理现象。

检验和放置可以更快、更可靠地进行。

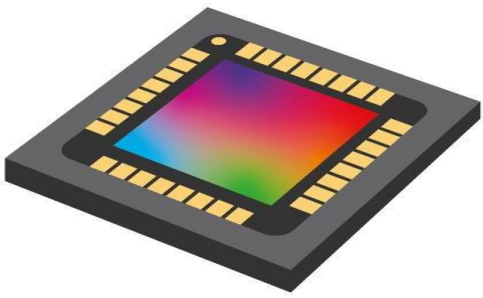


多输入输出模块

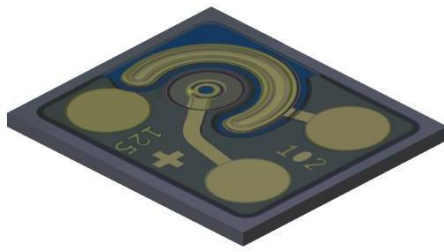
您的生产过程可能会有许多不同的运输路径，并且您的组件需要使用许多不同的运输设备来处理。

因此，**Levio**设计有多种输入和输出，以更好地适应您现有的设施、机器和供应商。

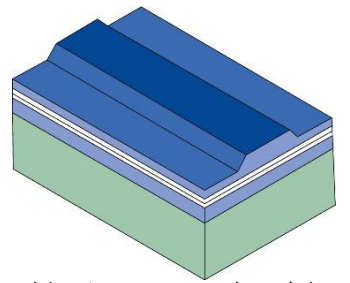
特殊的输入和输出载体可根据要求实施。



成像传感器



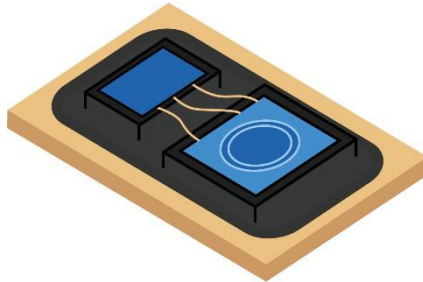
发射激光器



激光器二极管



LED



微机电系统



透镜

多个应用程序

无接触自动化技术已经能够成功地
操作任何材料和各种形状的组件。

此功能与Aatec在流程开发和自动化方面的专业知识相结合，
使Levio可以在您现有的流程中轻松实施并发展。

基础配置

- 带安全保护和电子柜的焊接框架/底板
 - 两侧的门
 - 触摸屏人机界面
 - 带xy动态的走向模块
 - 非接触式取放工具
 - 高精度运动控制/定位
 - CE认证
- UPH:1000-1500件/小时

尺寸与其他参数

- 电压 220-240 VAC / 12A Max
- 空气压力 6 Bars 最大
- 尺寸:
 - L = 1700mm
 - W = 1100mm
 - H = 1700mm
- 重量: 600 kg

适用范围

- 从 0.5x0.5mm 到 10x10mm的任意尺寸
- 任何材料 (GaAs, GaN, Glass, ...)
- 脆弱的表面和微电子

功能

- 输入:
 - 芯片4" to 12"
 - 最多 6 个4"Waffle托盘
 - 最多 20个 2" Waffle托盘
 - 2个Jedec 托盘
- Outputs:
 - 最多6个 4"Waffle/Gel Pak 托盘
 - 最多20个2"Waffle/Gel Pak 托盘
 - 2个Jedec托盘
 - 带式 and 卷轴式模块 (可选)
- 翻转模块(可选)
- 视觉检测模块(顶部/底部)

Touchless Automation GmbH

Rue David Moning, 8
2504 Biel/Bienne, Switzerland

Your direct contact

Maurizio Migliore, COO

Mobile: +41 (0) 78 405 63 31

Fax: +41 (0) 32 343 60 39

Email: maurizio.migliore@touchless-automation.ch



